

Einladung



ZUM TRADITIONELLEN Forum Leiterplatte Schweiz

Wir freuen uns sehr, Sie zum diesjährigen traditionellen Forum Leiterplatte Schweiz einzuladen. Ein abwechslungsreicher Nachmittag mit spannenden Vorträgen zu aktuellen Themen erwartet Sie.

Im Namen des Vorstands Verein Leiterplatte Schweiz wünschen wir allen Beteiligten eine interessante und spannende Veranstaltung mit vielen Kontakten und wertvollen Anregungen im Kreise der Leiterplattenhersteller aus der DACH Region.

Datum: Dienstag, 8. Oktober 2024

Beginn: 13:30h

Ort: Tagungszentrum Uediker-Huus
im Spilhöfler
CH-8142 Uitikon ZH
(Parkplätze sind genügend vorhanden)

Anmeldung: auf www.leiterplatteschweiz.ch

Kosten: CHF 125.00
(Zahlung bei Anmeldung; Bargeldzahlungen sind nicht mehr möglich)

Programm

Moderator: Romeo Premerlani, Market Development Manager
bei Varioprint AG, CH-9410 Heiden; Vize-Präsident VLS

13:30 Uhr **Begrüssung**
Pascal Oberson, Verkaufsleiter bei Optiprint AG, CH-9442 Berneck;
Präsident VLS

13:40 Uhr **Marktanalyse Europa (speziell D / A / CH)**
Remo Fischer, Betriebsleitung bei Hofstetter PCB AG, CH-6403 Küssnacht

13:55 Uhr **Verbesserung des Verpressens von Leiterplatten**
Uwe Postelmann, Senior Sales Manager Lamination Division bei
Lauffer Pressen GmbH & Co. KG

Verbesserung des Verpressens von Leiterplatten: Für die Verbesserung der Positionierung der Innenlagen zur Außenlage ist die Nutzung des MULTIS-TAGE-Verfahrens ein wirksamer Weg zu präziserer Kontrolle und Qualitätssteigerung.

Erhöhung der Pressgeschwindigkeiten für flexible Leiterplatten (PCBs): Die Pressgeschwindigkeiten können durch gezielte Maßnahmen erhöht werden, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Energieeinsparung durch moderne Heiztechnologien: Moderne Heiztechnologien bieten erhebliche Energieeinsparungspotentiale.

Zusätzlich möchte ich die Induktionsheizungstechnik vorstellen, die besonders bei Temperaturen ab 350°C präzise und schnelle Erwärmung sowie hohe Energieeffizienz bieten kann.

14:40 Uhr **PFAS – «Von forever zu no, no never chemicals» und der Paradigmenwechsel in der Chemikalienregulierung**
Kirsten Metz, Senior Manager Chemicals and Environmental Policy im Bereich Nachhaltigkeit & Umwelt bei ZVEI e.V.

Universelle PFAS-Beschränkung unter REACH

– Aktueller Stand des Verfahrens

– Einschätzung und Empfehlungen des ZVEI

Weitere aktuelle Entwicklungen rund um die Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit, REACH, RoHS und Co., u.a.

- REACH Restrictions Roadmap

- Flammschutzstrategie

- Substitutionsplanung und «Innovationsförderung»

15:25 Uhr **Laserbohren**

Dr.-Ing. Stefan Rung, Technical Director Laser Machines bei Schmoll Maschinen GmbH

Das Micro Via Bohren mit Lasern ist eine fortschrittliche Technologie, die präzise und effiziente Bohrungen in Leiterplatten ermöglicht. Ultrakurzpulslaser spielen dabei eine entscheidende Rolle, da sie aufgrund ihrer hohen Präzision und geringen thermischen Beeinflussung ideal für die Bearbeitung empfindlicher Materialien sind. Mit innovativen Bearbeitungsstrategien und optischen Konfigurationen sind dadurch Micro Via Durchmesser bis unter 10 µm erzielbar. Diese Methode verbessert die Qualität und Zuverlässigkeit der Verbindungen in modernen elektronischen Geräten erheblich und ist ein entscheidender Schritt in der Miniaturisierung und Leistungssteigerung von Elektronikkomponenten.

16:10 Uhr **Pause**

16:45 Uhr **Funktionalisierung von Leiterplatten durch die Einführung alternativer Metalle durch gesputterte Schichten**

Dr. Evelyne A. Parmentier, R&D Ingenieurin bei Dyconex AG

In der innovativen Leiterplattenindustrie erforschen die Unternehmen zunehmend verschiedene Metalle, um ihre Produkte mit speziellen Eigenschaften zu versehen, die den Kundenbedürfnissen entsprechen. Diese Metalleigenschaften spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Funktionalität von Leiterplatten.

Um diese wünschenswerten Eigenschaften in Leiterplatten zu integrieren, kann das Sputtern (oder auch Kathodenerstäubung) eingesetzt werden.

Wir haben ein spezielles Verfahren entwickelt, mit dem wir funktionalisierte Leiterplatten mit gesputterten Metallschichten herstellen können. Durch die Minimierung der fotolithografischen Schritte und die Gewährleistung einer optimalen Überlappung von Kupfer und Metall können wir die gewünschten Eigenschaften effizient in die Leiterplatte integrieren und gleichzeitig mögliche Probleme an den Kupfer-Metall-Grenzflächen vermeiden.

17:30 Uhr **Tintenstrahldruck als additive Fertigungstechnologie (Englisch)**

Dr. Luca Gautero, Produkt Manager bei Süss MicroTec

Der Tintenstrahldruck ist eine vielseitige additive Fertigungstechnologie. Der SÜSS JETxSM24, ein hochmoderner Tintenstrahldrucker, ist darauf ausgelegt, diese Vielseitigkeit für die Anforderungen der Lötmaskenbeschichtung in der Leiterplattenfertigung zu bieten.

Dank eines speziellen CAM-Add-ons, der «JETxSM Flow Engine», ermöglicht das Tool eine präzise Kontrolle über Lötmaskenmuster und deren lokale Dicke. Diese verbesserte Fertigungskapazität erweitert die Möglichkeiten der

Konstrukteure für kundenspezifische Profile ohne die Einschränkungen herkömmlicher Werkzeuge. Diese Flexibilität erhöht die Designfreiheit und beschleunigt Innovationen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Tintenstrahldruck die Anwendung von Lötstoppsmasken inspiriert, indem er mehr Flexibilität, weniger Abfall, schnellere Durchlaufzeiten und eine nahtlose Integration in die digitale Fertigung bietet.

18:15 Uhr ***Schlusswort***

18:20 Uhr ***Apéro mit anschließendem Nachtessen***
und gemütlichem Beisammensein